

项目名称		基于多材料体系光子芯片中试平台项目									
项目类型（一级）		新型基础设施									
项目类型（二级）		其他新型基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.7900									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		本项目的建设内容与建设规模为：本项目规划建筑面积约12067平方米（综保区二期4号楼地下一层、地上一层与地上二层），搭建全流程光子芯片中试平台，覆盖晶圆清洗、薄膜沉积、光刻、刻蚀、异质集成、封装测试全核心工艺；同步配套建设纯水、特气、真空、废水处理、UPS不间断供电等配套设施；可满足量子信息、高速光通信、光计算领域企业及科研机构研发测试、工艺迭代、中试验证等公共服务需求。									
项目建设期		2026年至2028年									
项目运营期		2028年至2047年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		20年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		7.7840									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.5840									
专项债券融资（亿元）		6.2000									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.2100	0.7900	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益（亿元）			10.8874								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0441	2029年	0.3486	2030年	0.4678	2031年	0.7421	2032年	0.6939
2033年	0.6195	2034年	0.6195	2035年	0.6945	2036年	0.6945	2037年	0.6071	2038年	0.5859
2039年	0.5859	2040年	0.5859	2041年	0.5859	2042年	0.5859	2043年	0.5859	2044年	0.5735
2045年	0.5735	2046年	0.5676	2047年	0.1256	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.7253	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.76		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				8.7253	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.25		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.76		
项目收益预测依据				行业调研报告及类似项目收入、成本测算数据							